

# EXPERT 10.6 HV

Reworkstation mit 3300 W

Reworkstation mit insgesamt 3300W Heizleistung in Hybrid-Technologie auf 275 x 245 mm<sup>2</sup>. Heizfläche passend zur LP Abmessung einstellbar. Automatisches Platzieren der SMD Bauteile mit Auto-Vision-Placer (AVP) inkl. EASYSODLER 07 Softwarepaket und

DBL 06 Steuergerät mit sechs hochauflösenden Temperatureingängen (Typ K). Dieses Gerät ist besonders geeignet für mittlere und große Leiterplatten mit Fine-Pitch Komponenten unterschiedlichster Bauformen.

## Top Features

Kameragestütztes Rework



### Flexibilität

verschiedene PCB Größen und Formen sowie Bauteile möglich



### Unterheizung

Höchste Energiedichte für thermisch anspruchsvolle Boards



### Performance

Uniforme Wärmeverteilung durch Konvektions- und Hybridtechnologie



### Multifunktionalität

Alle Prozesse an einem Gerät: Lot Absaugen, autom. Positionierung, Löten und Entlöten



### Software

einfach, intuitiv, Tablet kompatibel

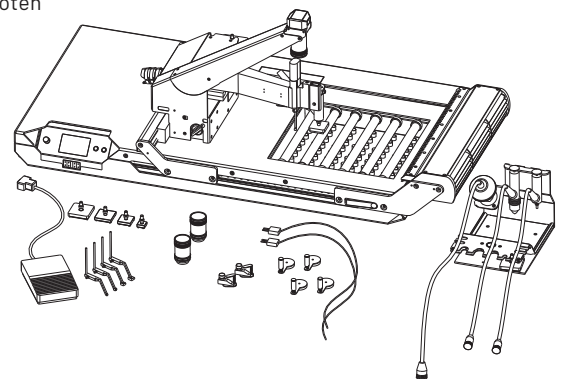


### Präzision

Platziergenauigkeit bis 15 µm

## Ausstattung

- Arbeitsgriffel mit Magazinständer für Dosieren, Bestücken, Altlotabsaugen und Löten
- Satz Bestück-Pipetten für BGA/CSP 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- Satz Löt-Werkzeuge (BGA) 15 mm, 27 mm, 35 mm, 40 mm
- Zwei Objektive (BGA und CSP)
- Zwei Sensoren (Typ K) für Temperaturmessung
- Vier Leiterplatten-Magnethalter 40,5 mm (Standard)
- Zwei Leiterplattenklammern zur Montage in der Handauflage
- Fußtaster



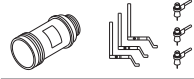

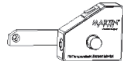
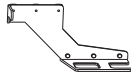
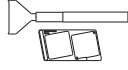
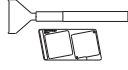
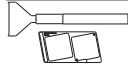
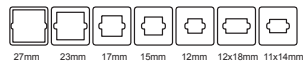
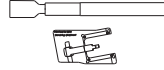
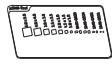

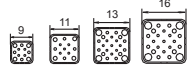
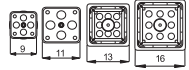
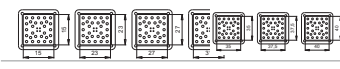
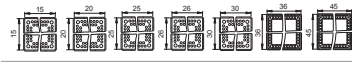




## Technische Details

<b>Gesamtleistungsaufnahme:</b>	3500 VA	
<b>Leistung Lötgriffel:</b>	300 W, 35 l/min	
<b>Leistung Unterheizung:</b>	600-3000 W	6 x IR-Lampen
<b>Größe Unterheizung:</b>	275 x 245 mm <sup>2</sup>	
<b>Empf. max. Leiterplattengröße:</b>	305 x 305 mm <sup>2</sup>	
<b>Auflösung Positionierachsen:</b>	0,001 mm	
<b>Platziergenauigkeit:</b>	± 0,015 mm	(Flip Chip)*
	± 0,030 mm	(CSP)
	± 0,040 mm	(BGA)
	± 0,070 mm	(Maxi BGA)*
	± 0,115 mm	(Maxi BGA XL)*

<b>Hochaufl. CMOS-Kamera:</b>	5 Mio. Pixel USB2	
<b>Bildausschnitt:</b>	14 x 18 mm <sup>2</sup>	(Flip Chip)*
	28 x 37 mm <sup>2</sup>	(CSP)
	37 x 50 mm <sup>2</sup>	(BGA)
	65 x 85 mm <sup>2</sup>	(Maxi BGA)*
	115 x 160 mm <sup>2</sup>	(Maxi BGA XL)*
<b>Elektrischer Anschluss:</b>	1Phase, 230VAC, 25A	Stecker CEE 32A (3-phasig)
<b>Druckluft:</b>	5-8 bar, 100 l/min,	gereinigte, trockene Luft
<b>Systemabmessungen:</b>	865 x 460 mm <sup>2</sup>	

\*Ergänzungsbaustein

## EXPERT 10.6 HV: Ergänzungsbausteine

	Artikel nr.	Name
	SF66.0004	Mikro-SMD-Ergänzung für AVP 4 Lizenz MS, 3 Pip, 3 Löt-Saug-D, Obj. FC
 <span data-bbox="266 369 310 385">Report</span>	DVSX.0007	Report mit LP-Identifikation für ES-05, Lizenz RP
	SF71.0003	IR-Temperatursensor für AVP04.1
	SF64.0501	Tool Slider für AVP 4.1
	SF64.0525	Dipp Tool 32x0,08mm mit Rakel für Tool Slider
	SF64.0526	Dipp Tool 32x0,15mm mit Rakel für Tool Slider
	SF64.0527	Dipp Tool 32x0,22mm mit Rakel für Tool Slider
 <p data-bbox="151 897 451 920">27mm 23mm 17mm 15mm 12mm 12x18mm 11x14mm</p>	AT10.0100	Chip Rahmen Set Dipp Tool 7 Stück (11x14,12x18,12,15,17,23,27)
	SF64.0520	Print Tool mit Rakel für Tool Slider
	SF64.0540	µSMD Tool für Tool Slider
 <span data-bbox="282 1111 342 1141">Maxi-BGA AVP4</span>	SF66.0110	Objektiv Maxi-BGA für AVP4/4XL, f=16mm, 65*85mm
	LW40.1096	Löt-Werkzeug-Set-CSP/QFN für alle CSP-Typen, 4 Stück (9, 11, 13, 16)
	LW40.1104	Löt-Werkzeug-Set CSP mit Vakuum^ für alle CSP-Typen, 4 Stück (9, 11, 13, 16)
	LW40.1099	Löt-Werkzeug-Set BGA 7 für alle (98%) BGA-Typen, 7 Stück
	LW01.0100	Löt-Werkzeug-Set QFP für alle PLCC ...QFP, 7 Stück
	SF36.1001	Leiterplatten-Flex-Unterstützung 40,5 für HIF-08 und IRF-Strahler, 10-Punkt-Kissen
	SF71.0004	Seitenkamera (Objektiv 35mm) für ES-05, Kamera, Ständer, Kabel, DVD
	SF71.0007	Objektiv Seitenkamera f=16mm
	DB00.0025	Stickstoff-Anschluss DBL-04/05/06 (2.D.M) verringert N2-Verbrauch bei Vakuum

Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterial unter [www.martin-smt.de](http://www.martin-smt.de)